

OBSAH

1 ÚVOD.....	7
2 POLOVODIČOVÉ ČIPY – ZÁKLAD ELEKTRONICKÉHO HARDWARE.....	9
3 POUZDRA A VÝZNAM POUZDŘENÍ	19
4 COB (DCA) TECHNOLOGIE	26
5 KONTAKTOVÁNÍ POLOVODIČOVÝCH ČIPŮ – WIREBONDING.....	31
5.1 ULTRAZVUKOVÉ KONTAKTOVÁNÍ	32
5.2 TERMOKOMPRESNÍ KONTAKTOVÁNÍ	34
5.3 TERMOSONICKÁ METODA KONTAKTOVÁNÍ.....	36
5.4 KULIČKOVÝ VERSUS HRANOVÝ SVÁR	36
5.5 PARAMETRY PŘI KONTAKTOVÁNÍ A NASTAVENÍ PROCESU	37
5.6 TVAROVÁNÍ SMYČKY A ROZLOŽENÍ PLOŠEK PRO KONTAKTOVÁNÍ.....	41
5.7 MATERIÁLY MIKRODRÁTKU	43
5.8 VÝKONOVÉ APLIKACE	45
5.9 DIAGNOSTIKA SPOLEHLIVOSTI MIKRODRÁTKOVÝCH SPOJŮ	46
5.10 PORUCHOVÉ MECHANIZMY PŘI KONTAKTOVÁNÍ ČIPŮ A JEJICH PŘÍČINY	48
6 ZÁVĚR.....	52